

广安pcb OSPpcb 中雷pcb

产品名称	广安pcb OSPpcb 中雷pcb
公司名称	东莞市中雷电子有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇乌沙新安工业区睦邻路7号
联系电话	14781837388

产品详情

pcb电镀填孔工艺的优势及影响因素

pcb电镀填孔有以下几方面的优点：

- (1)有利于设计叠孔和盘上孔
- (2)改善电气性能，有助于高频设计
- (3)有助于散热
- (4)塞孔和电气互连一步完成
- (5)盲孔内用电镀铜填满，可靠性更高，导电性能比导电胶更好。

影响pcb电镀因素有：

物理影响参数

需要研究的物理参数有：阳极类型、阴阳极间距、电流密度、搅动、温度、整流器和波形等。

基板的影响

基板对电镀填孔的影响也是不可忽视的，一般有介质层材料、孔形、厚径比、化学铜镀层等因素。

pcb贴片有哪些注意事项

保证pcb贴片质量的三要素：

一点是元件要正确

要求各装配位元器件的类型、型号、标称值和极性等特征标记要符合产品的装配图和明细表要求，不能贴错位置。

第二点是位置要正确

元器件的端头或引脚均和焊盘图形要尽量对齐、居中，还要确保元件焊端接触焊膏图形。两个端头的元件自定位效应的作用比较大，pcb贴片贴装时元件宽度方向有3/4以上搭接在焊盘上,长度方向两个端头只要搭接到相应的焊盘上并接触焊膏图形，再流焊时就能够自定位，但如果其中一个端头没有搭接到焊盘上或没有接触焊膏图形，再流焊时就会产生移位或吊桥；对于芯片类器件的自定位作用比较小，pcb贴片贴装偏移是不能通过再流焊纠正的。如果pcb贴片贴装位置超出允许偏差范围，必须进行人工拨正后再进入再流焊炉焊接。否则再流焊后必须返修，会造成工时、材料浪费，甚至会影响产品可靠性。生产过程中发现贴装位置超出允许偏差范围时应及时修正贴片坐标。贴装时位置要正确，引脚于焊盘对齐居中。pcb贴片压力要适中，压力过大会造成锡膏连接，压力过小锡膏粘不住元器件

关于pcb镀镍、镀锌、镀铬

通过电解或化学方法在金属或某些非金属上镀上一层镍的方法，称为pcb线路板镀镍。

那么pcb镀镍它的颜色是白银显黄色，其作用呢一是防锈二是耐磨和美观，

pcb镀铬主要是提高表面硬度

pcb镀锌主要是美观

防锈，但耐腐蚀性比较差，所以镀锌是这三种里面zui便宜的了，镀镍的话相对来说会比较贵一点的

那这三者的区别也就是从外观、硬度、耐腐蚀来区分的。